

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成31年4月25日 (2019.4.25)

【公表番号】特表2018-511168(P2018-511168A)

【公表日】平成30年4月19日 (2018.4.19)

【年通号数】公開・登録公報2018-015

【出願番号】特願2017-545244(P2017-545244)

【国際特許分類】

H 0 1 L 21/8234 (2006.01)

H 0 1 L 27/088 (2006.01)

H 0 1 L 29/06 (2006.01)

H 0 1 L 29/861 (2006.01)

H 0 1 L 29/868 (2006.01)

H 0 1 L 27/06 (2006.01)

H 0 1 L 21/822 (2006.01)

H 0 1 L 27/04 (2006.01)

H 0 1 L 29/78 (2006.01)

H 0 1 L 21/76 (2006.01)

H 0 1 L 29/739 (2006.01)

H 0 1 L 21/8238 (2006.01)

H 0 1 L 27/092 (2006.01)

H 0 1 L 29/872 (2006.01)

H 0 1 L 29/786 (2006.01)

【 F I 】

H 0 1 L 27/088 E

H 0 1 L 29/06 3 0 1 D

H 0 1 L 29/91 D

H 0 1 L 27/088 3 3 1 E

H 0 1 L 29/06 3 0 1 V

H 0 1 L 27/06 1 0 2 A

H 0 1 L 27/04 U

H 0 1 L 29/78 6 5 3 A

H 0 1 L 29/78 6 5 2 H

H 0 1 L 29/78 6 5 6 C

H 0 1 L 29/78 6 5 6 E

H 0 1 L 29/78 6 5 5 A

H 0 1 L 27/092 B

H 0 1 L 29/86 3 0 1 F

H 0 1 L 29/91 K

H 0 1 L 29/78 6 1 3 A

H 0 1 L 29/78 6 1 3 Z

H 0 1 L 27/04 H

【手続補正書】

【提出日】平成31年2月20日 (2019.2.20)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 0 2

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0002】

システムコストを削減し、機能性を高め、高い精度と効率を実現する必要性が高まっているため、半導体は常に高集積化に向かって進んでいる。1 若しくはそれ以上の縦型電力装置と、単一のダイ内のロジック、アナログ、混合信号回路、センサとを集積することは多くのアプリケーションにとって利点がある。この利点には、集積による製品コストの削減、高機能化、構成要素適合性の改善、共有基板による熱適合性の改善などがある。

この出願の発明に関連する先行技術文献情報としては、以下のものがある（国際出願日以降国際段階で引用された文献及び他国に国内移行した際に引用された文献を含む）。

（先行技術文献）（特許文献）

（特許文献1）	米国特許出願公開第2013/0249001号明細書
（特許文献2）	米国特許出願公開第2012/0161286号明細書
（特許文献3）	米国特許出願公開第2008/0266922号明細書
（特許文献4）	米国特許出願公開第2014/0094009号明細書
（特許文献5）	米国特許第5,578,841号明細書
（特許文献6）	米国特許出願公開第2007/0138648号明細書